

## 低誘電有機絶縁材料生産プラント建設投資決定のお知らせ ～約70億円の戦略投資により高速通信技術確立に貢献～



<スネクトン®>

デンカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井 俊夫）は、低誘電有機絶縁材料（製品名：スネクトン®）生産のため、約70億円の設備投資を決定いたしました。

当社が開発したスネクトン®は、次世代高速通信（Beyond5G、6G）において、電気信号の損失（伝送損失）を低減させるために素材に要求される電気特性（低誘電率、低誘電正接）を備えており、既に各種高速通信機器の銅張積層板（CCL）や層間絶縁材用途などで、多くのお客様より高い評価を得ており、今後大幅な需要拡大が見込まれます。

従来のエポキシ樹脂をベースとしたCCLでは、次世代高速通信用途としては伝送損失面で課題が有りましたが、当社のスネクトン®は要求される低伝送損失を実現したことに加え、軟質樹脂でありながら架橋性（耐熱性）も有する特徴を持つ最先端有機素材です。また、完全硬化後も軟質性を有することから、フレキシブル銅被覆板（FCCL）への適用も可能で、PC、スマートフォン、データセンター、携帯電話基地局、ウェアラブル端末、自動車など幅広い分野での活用が期待されます。

当社は2023～2030年度の8カ年を対象とした経営計画「Mission 2030」において、「ICT&Energy」分野では800億円の戦略投資枠を定めており、今回の投資はその中でも中核の1つと位置付けて実行いたします。

デンカはこれからも、「化学の力で世界をよりよくするスペシャリストになる」というパーパスのもと、世界に誇れる化学で、人々の暮らしと社会に貢献し続けます。

以上

**【投資概要】**

- ・投資拠点：千葉工場（千葉県市原市）
- ・投資金額：約 70 億円（見込）
- ・主な内容：生産プラントの建設
- ・竣工時期：2026 年度（予定）

※本件による 2024 年度当社連結業績への影響は軽微です。

**【報道関係者からのお問い合わせ先】**

コーポレートコミュニケーション部 電話：03-5290-5511

**【お客様からのお問い合わせ先】**

電子・先端プロダクツ部門 先端機能材料部 電話：03-5290-5539